

# DKNリサーチニュースレター

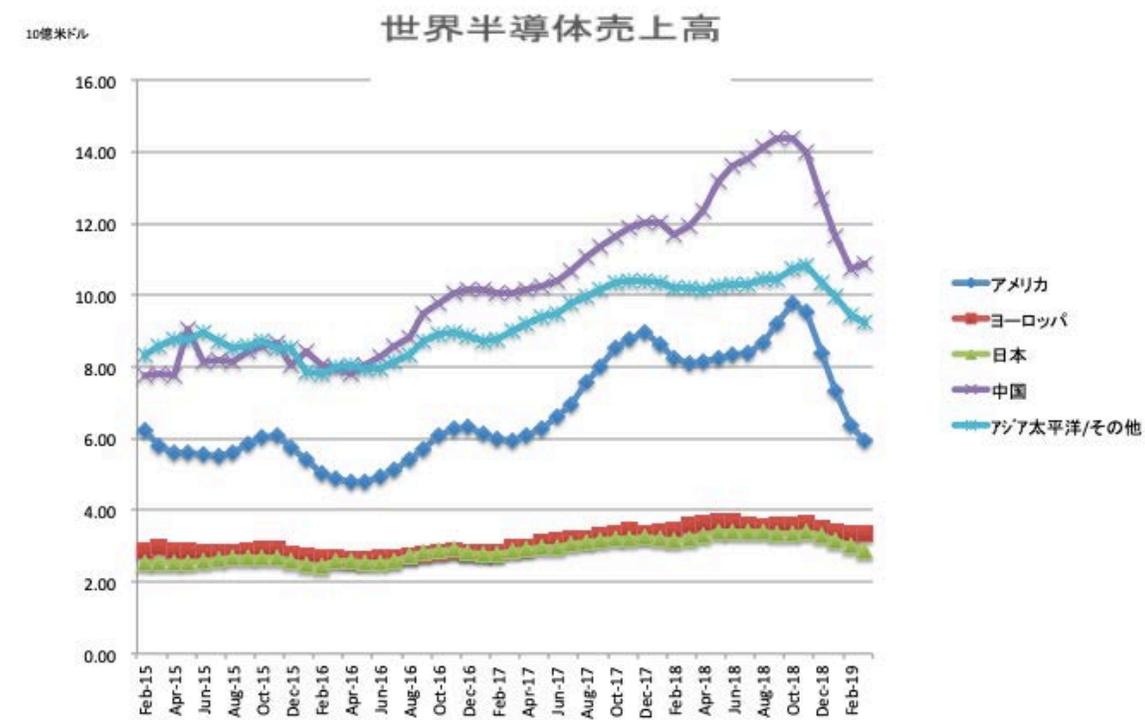
#1915、2019年6月2日（日本語版）  
（エレクトロニクス実装の最新海外情報）

## 今週の話題

### エレクトロニクス業界の低迷は底を打ったか？

今回のエレクトロニクス業界の低迷については腑に落ちない点がいくつかあります。

市場の急落は昨年（2018年）の12月に突然始まりました。それから3ヶ月間、世界の半導体製品の出荷、世界の電子部品の出荷、台湾のプリント基板業界の出荷、日本のプリント基板業界の出荷は減少しつづけてきました。それが、3月（2019年）に入って、少し状況は変わってきています。



世界の半導体製品の出荷額の下落は、かなり緩やかになっています。ただし、地域別に分けると、中国の3月の出荷額は、わずかですが反発して増加に転じています。その他の地域は、多少下落率は小さくなっているとはいうものの、依然として減少傾向にあります。特に北米の減少率は際立っています。グラフに出てくる傾向からだけでは、この先のことは予測しにくい状況が続いているといっていよいでしょう。それでも、この先1～2ヶ月の動きを観察すれば、予測の確かさは、はるかに良くなるでしょう。



6. Intel (米国の半導体メーカー大手) 5 / 28  
スマートフォンのような民生用電子機器に使われるBGA接続の、機械的な衝撃に対する耐久性について評価。
7. LCOA (米国の基板材料メーカー) 5 / 28  
多層の硬質基板やリジッド・フレックスのドリリングの品質を向上するための、新しいコンフォーマルバックアップ材料を開発。
8. YINCAE Advanced Materials (米国エンジニアリング会社) 5 / 28  
LGA(Land Grid Array)パッケージの修理を容易にするアンダーフィル材料を開発。室温での処理が可能。
9. Chalmers University of Technology (スウェーデン) 5 / 28  
表面に銀をコーティングしたプラスチック微粒子を導体として使った導電性接着剤を実用化。
10. IDC (米国の市場調査会社) 5 / 23  
2019年における世界のCellular Connectivityの出荷は、前年比45.4%増の5110万台になると予測。2023年には7630万台に成長。5年間の平均16.8%/年の成長率。
11. ITM Consulting (米国のコンサルティング会社) 5 / 24  
多層リジッド・フレックスのリフローはんだ付けプロセスについて現実的なソリューションを紹介。

(注) このヘッドライン・ニュース・レターは速報性を重視するために、若干の誤訳や数字の変換に誤りがある場合もございます。ご了承下さい。

DKNリサーチ  
栄泰産業株式会社

#### DKNリサーチのイベントスケジュール

- \* 6月28日、技術セミナー「フレキシブル・デバイスにおける材料・加工の現在－医療・ヘルスケアを中心にウェアラブル用途を目指す－」、加工技術研究会、東京、北トピア、<http://www.ctiweb.co.jp/seminar/dkn2019/index.html>
- \* 3月26、27日技術セミナー「フレキシブルエレクトロニクス最前線、応用市場の現状と将来、材料・生産技術の最新動向」工業技術研究院、台湾新竹市

最近のDKNリサーチの論文、出版物

\* 「デザイン革命、見せる魅せる透明フレキシブル基板」沼倉研史、JPCA NEWS, NO. 591, 2017年12月

\* 「ウェアラブル時代に向けての新しい加工技術」沼倉研史、コンバーテック、2018年6月号、加工技術研究会

\* 「耐熱性透明フレキシブル基板の材料と加工技術」沼倉研史／溝口昌範、エレクトロニクス実装技術、2018年6月号、

下記URLを開けてみてください。最近のものの一覧をみることもできます。コピーライトの問題がないものは全文を閲覧することもできます。

<http://www.dknresearchllc.com/DKNRArchive/Newsletter/Newsletter.html>

<http://www.dknresearchllc.com/DKNRArchive/Articles/Articles.html>